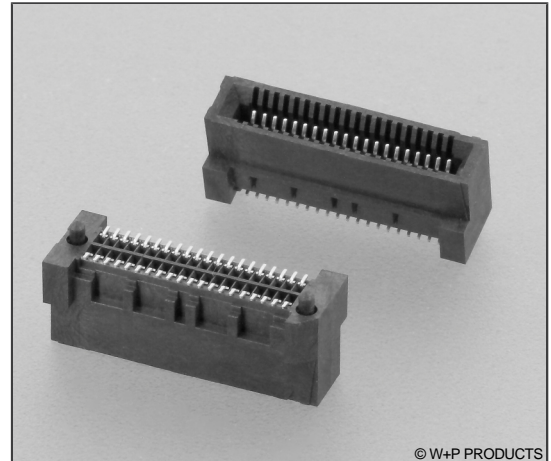


1280

SMT Mini Card Edge Verbinder RM 0,80mm, stehend SMT Mini Card Edge Connectors 0.80mm Pitch, vertical

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to plating options, over Ni
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	3,1A bei 30°C Erwärmung
Current Rating	3.1A at 30°C Temperature Rise
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Für Steckkarten mit einer Stärke von 1,57±0,10mm

For 1.57±0.10mm card edge thickness

Übertragungsverlust -3dB

Insertion loss -3dB

Stapelhöhe 7,98mm

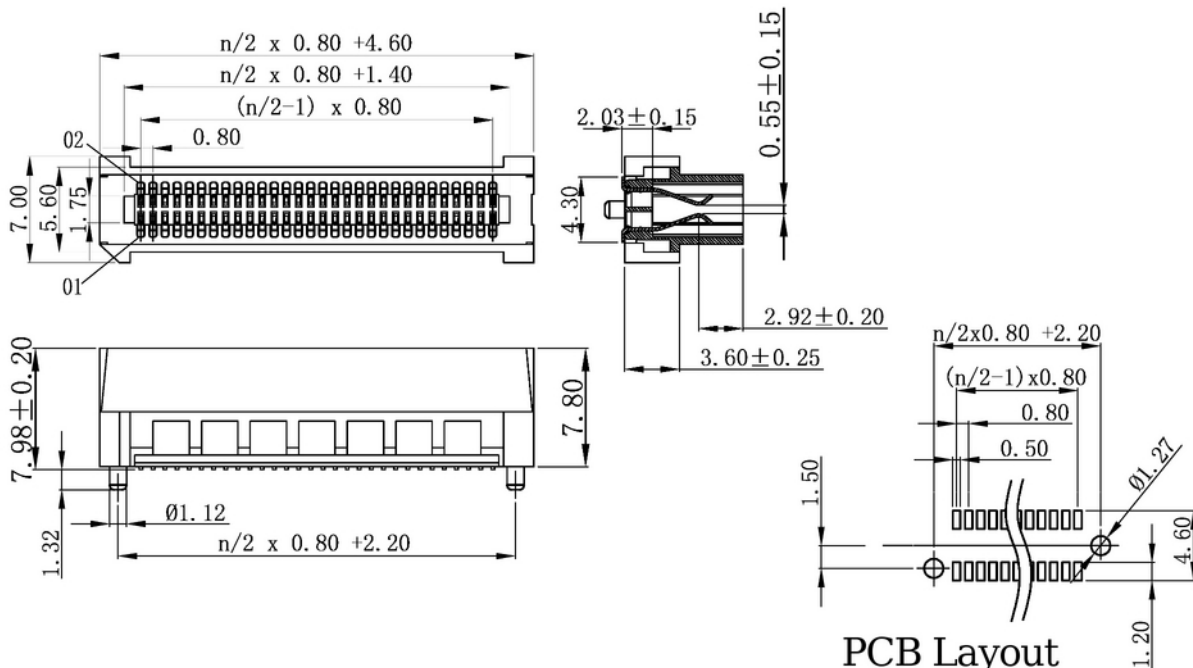
Stack height 7.98mm

Asymmetrische Übertragung 8GHz/16Gbps

Single-ended Signaling 8GHz/16Gbps

Symmetrische Übertragung 10.5GHz/21Gbps

Diff. pair signaling 10.5GHz/21Gbps



PCB Layout

Series	Contacts*	Type	Plating*	Packaging*
1280	040	1	80	PPST
	020 040 060	1 Standard	00 Au flash 60 Sel. Au flash /Sn 80 Sel. 0,75µm Au /Sn	ST PPST PPTR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

PPST In Stangen mit PP-Pads / In tubes with PP-Pads

PPTR Tape & Reel mit PP-Pads / Tape & Reel with PP-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

